

バーチカルワイドブロー(垂直噴霧)方式 インライン型 スプレーフラクサー・DS-350

抜群の塗布効率と高いメンテナンス性を実現！
スルーホール内部へのフラックス浸透力に優れた次世代機登場！



特徴

フラックスを垂直に噴霧できるので、スルーホール内部への浸透力が高く、溶融ハンダのフローアップを助長します。

フラックスを一定幅で均一に噴霧するバーチカルワイドブロー方式の採用により、ミストの飛散が大幅に軽減されます。

噴霧量数値(cc)表示機能により、最適な塗布条件を正確に把握できます。

作業終了後に取り外したドラムを付属の洗浄管に入れるだけの簡単メンテナンス。

チェーン洗浄液用のタンクを2槽に分ける事で、常にきれいな液を供給できるため、搬送系(爪)の汚れを軽減します。

基板の上下両方向からミストを完全吸引/回収できるので、リターンシャワーがなく、大きな開口部のある基板やマシン目(カットアウト)型集合基板に対しても有利に使用できます。

項目	方式	ノズルスイング式	バーチカルワイドブロー方式
特徴		噴霧圧、フラックス流量などを調整する事で塗布特性を自由に変えられる上、均一性に優れるという利点を持つ反面、スイング動作による乱流がフラックスの直進性と塗布効率を妨げる	回転する円筒形の金属メッシュに付着したフラックスをエア圧で霧状に砕いた後、垂直に噴霧する機構(改良ドラムメッシュ)を内蔵。ノズル式と発泡式の両方の利点を併せ持つ塗布方式
スルーホール浸透性		低い	高い
ミスト飛散		多い	少ない
ミストの回収		集塵機の併用が原則	簡易フィルター式が標準
噴霧イメージ			

薄く均一な塗布を可能にする内部機構 (改良ドラムメッシュユニットによるロータリー噴霧)

薄く幅広いカーテン状の噴霧が可能のため、ノズルをスイングさせる必要がなく、集塵も簡単に回収効率も高くなります。



装置仕様

対応基板幅	最小	45mm
	最大	350mm
基板下リード長さ		Max.40mm
搭載部品高さ		Max.120mm
電源・電力		3相 200V 0.6kw
エア圧力		5kg / cm ²
フラックス噴霧量(ポリウム)		Max.100cc / 分
搬送スピード		Max.2.5m / 分
搬送幅調整		手動(ハンドル式)
集塵	方式	上下簡易集塵機構(メッシュフィルター交換式)
	ブロー・排気量	15m ³ / 分
フラックス供給方式		ポンプによる自動供給
爪洗浄	方式	ブラシ洗浄(IPA供給)
	ポンプ	35w
装置外形寸法・重量	1,200(L) × 1,020(W) × 1,650(H) mm / 本体重量：約200kg (入口・出口コンベアの突起部およびパトライトを含む)	

爪洗浄機構

IPAを供給しながらブラシでフラックス汚れを落とします。



IPAタンクは2槽に分かれており常にきれいな液を供給できる構造になっています。



ミスト回収・排気機構

噴霧機構の下方にはフラックス受けトレイ(引き出し式)が備え付けられており、装置周辺が汚れるのを防止



排気ブローアと下部吸引ミスト用カセットフィルター



簡単に交換できる上部メインフィルター(メッシュカセット引き出し式)



製造元 National Solbot Electronics Industrial Co.,LTD

販売元 株式会社 TECHNITRON SUPPLY CORPORATION 東京都品川区南大井3-31-19 エイコウ大森ビル6F
TEL: 03(5753)8781 FAX: 03(5753)8780
http://www.technitron.co.jp